

10月23日(月)10:00-13:00
KM-1 挨拶・基調講演 10:00-13:00 (受付・ウェルカムコーヒー 9:30 開始)
司会:中村 孝(大阪大学) ◆来賓挨拶 京都府副知事 山下 晃正 京都市長 門川 大作
◆10周年記念講演: 「SiCパワー半導体の基礎技術確立と社会実装への道」 京都大学 名誉教授 松波 弘之
◆基調講演: 「チップレット時代における半導体パッケージ革命」 Rapidus(株) 専務執行役員 3D/Aセンプリ本部長 折井 靖光
◆基調講演 「100兆円半導体市場を迎えて～製造装置メーカーの展望～」 (株)SCREENセミコンダクターソリューションズ 代表取締役 社長執行役員 後藤 正人
◆基調講演 「これが異次元段階に突入した電子デバイスの未来像だ！」 (株)産業タイムズ社 代表取締役会長 泉谷 渉

10月24日(火)9:20-11:45
KM-2 マーケティングセッション 9:20-11:45 (受付 8:50 開始)
司会:松下晋司(産業タイムズ社)
◆特別講演 「市況悪化と次の成長フェーズの双方に直面する 半導体・装置・電子部品業界」 (株)産業タイムズ社 大阪支局 支局長 電子デバイス産業新聞 副編集長 中村 剛
◆特別講演 「2024年度以降の電子機器・半導体市況 ～新たな半導体時代の始まり～」 インフォマインテリジェンス合同会社 C&Dコンサルティング 南川 明
◆特別講演 「フラットパネルディスプレイ・スマホなど完成品業界見通し: 24年、スマホやPC需要は回復するのか。技術変化や 今後の注目点は何か?」 みずほ証券(株) エキイ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー ・リサーチャー/シニアアナリスト 中根 康夫

コース	10月23日(月)14:00-16:40
【A】	A-1 環境エネルギー動向
環境 エネルギー	戸所義博(イーセップ)/山崎治(シャープフロンティアAT)
	◆ペロブスカイト太陽電池:実用化に向けた研究開発 京都大学 化学研究所 教授 若宮 淳志 ◆CO2選択透過膜(促進輸送膜)の CO2分離・回収プロセスへの応用 (株)ネッサンス・エナジー・リサーチャー 代表取締役社長 岡田 治 ◆電力制御を軸としたカーボンニュートラル推進 (株)村田製作所 技術・事業開発本部 新規事業推進部 新規事業推進1課 シニアマネージャー 堤 正臣

【B】	B-1 新時代デジタル動向
新時代デジタル 量子の幕開け	加藤千晴(村田製作所)/松村善夫(パナソニック)
	◆デジタルツインが実現する未来の街づくり 日本電信電話(株) NTTスマートデータサイエンスセンター センター長 社家 一平 ◆村田製作所は「様々な製造現場」を応援! 現場の改善支援ソリューションのご紹介 (株)村田製作所 IoT事業推進部 マネジャ 大谷 匡司 ◆コネクティッドカー活用に向けた技術開発動向 日本電信電話(株) NTTデジタルツインコンピューティング研究セ ンター 主任研究員 沖 寛宏

【C】	C-1 半導体の市場・技術動向
The 半導体	三富士道彦(ローム)/廣田良浩(ワイドヴィル)
	◆dTof-SPAD測距技術進化と展望 ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 第4研究部門 1部 1課 藤崎 裕太郎 ◆Beyond 2nmに向け GAA-NS-FETデバイス技術 東京工業大学 科学技術創成研究院 集積Green-nix+研究ユニット 教授 若林 豊 ◆再始動する半導体市場 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) インベストメントリサーチャー部 シニアアナリスト 和田 木 哲哉

【D】	D-1 最新のパッケージ・実装技術動向
跳躍の最先端 パッケージ・ 実装技術	森川泰宏(ULVAC)//藤原健典(東レ)
	◆先端パッケージの技術トレンド (株)SBRテクノロジ 代表取締役 西尾 俊彦 ◆2nm以降のパッケージはどのような? Rapidus(株) 3D/Aセンプリ本部長 シニアディレクター 野中 敏夫 ◆シリコンフォトニクスとポリマー光再配線をを用いた 光電コパッケージ技術の最新動向 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 プラットフォームフォトニクス研究センター 総括研究主幹 天野 健

【E】	E-1 大学セッション(無料) マテリアル先端リサーチンフラ
特別セッション	土屋智由(京都大学)/向井雅昭(京都工芸繊維大学)
	◆マイクロメータ搭載分析電子顕微鏡による半導体局所キャリア濃度評価 (株)東レリサーチセンター 形態科学研究所 第1研究室 室長 川崎 直彦 ◆微細加工電極技術を用いた1分子解析技術の開発 大阪大学 産業科学研究所 助教 小本 祐貴 ◆光子ホログラフィーによるダイヤモンドデバイスの不純物及び、 界面欠陥の原子配列の観測 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学領域 教授 松下 智裕 ◆半導体チップ接着フィルムの伸長レオロジー 山形大学 大学院 有機材料システム研究科 教授 杉本 昌隆

10月24日(火)12:35-14:50
A-2 次世代モビリティ
戸所義博(イーセップ)/山崎治(シャープフロンティアAT)
◆EVとe-POWERにおける電動パワートレインの進化 日産自動車(株) パワートレイン・EV技術開発本部 パワートレイン・EV電 動技術開発部 電動部品開発グループ 主管 佐藤 義則 ◆カーボンニュートラル実現に向けた電動車の普及課題と今後の対 応について (株)Blue Nexus 取締役 安部 耕生

【B】	B-2 量子コンピュータ(最新動向)
量子コンピュータ(最新動向)	松村善夫(パナソニック)/坂本健(NTT研究所)
	◆量子コンピューティング実用化に向けた取り組み 富士通(株) フォロー SVP 富士通研究所(量子研究担当) 量子 量子研究部長 佐藤 信太郎 ◆量子コンピュータの研究開発動向と未来 国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー 嶋田 義晴 ◆量子インターネットの研究開発の現状について 横浜国立大学 大学院 工学研究科 准教授 堀切 智之

【C】	C-2 装置技術・プロセス技術
装置技術・プロセス技術	森義弘(SCREEN)/廣田良浩(ワイドヴィル)
	◆SDGaと3D化を支える先端半導体洗浄技術 (株)SCREENセミコンダクタソリューションズ 洗浄開発統轄部 統轄部長 高橋 弘明 ◆ヘテロニアスインテグレーションに向けた ボンディング技術の研究 東京エレクトロニクス(株) ATS BU 3D部 部長代理 斉藤 健一 ◆先端メモリデバイスに向けた深穴ドレイエッチング技術動向 東京エレクトロニクス(株) 宮城 誠 技術戦略室 グループリーダー 坂本 渉

【D】	D-2 シリコンフォトニクス・コパッケージ・μLED
シリコンフォトニクス・コパッケージ・μLED	酒井滋樹(日新イオン機器)/不破保博(元ローム)
	◆シリコンフォトニクス技術を用いた 超小型光トランジスタ技術とその将来展望 アイオーコア(株) 実装技術統轄部長 竹村 浩一 ◆導電性ペーストを用いた多層ガラス基板の開発 FICT(株) テクノロジ本部 先行技術開発部 プロジェクト部長 酒井 泰治 ◆マイクロLED向けマストランスファ、実装技術の最新動向 東レエンジニアリング(株) メカトロファインテック事業本部 第一事業部 開発部長 森 英治

【E】	E-2 ChatGPTの社会インパクト
ChatGPTの社会インパクト	加藤千晴(村田製作所)/中村孝(大阪大学)
	◆生成AIの経営や現場へのインパクト、成果を出すために必要な条件とは (株)エクササイズズ 常務取締役 大植 拓真 ◆ChatGPTなどの大規模言語モデルの仕組みと 言語生成技術における研究課題 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究チーム長 高村 大也 ◆ChatGPTの仕組みと活用の未来像 日本マイクロソフト(株) カスタマーサクセス事業本部 Cloud Solution Architect 蒲生 弘輝

10月24日(火)15:15-17:30
A-3 パワーデバイスと周辺技術
佐藤高史(京都大学)/中村孝(大阪大学)
◆SiCパワーデバイス開発の現状と課題 富士電機(株) 半導体事業本部 開発統括部 デバイス開発部 担当部長 木村 浩 ◆パワーデバイスの実装とその評価 大阪大学 大学院 工学研究科 電気電子情報通信工学専攻 教授 舟木 剛 ◆パワーデバイス用SiC単結晶ウェハ開発の最新動向 関西学院大学 工学部 電気電子応用工学課程 教授 大谷 界

【B】	B-3 量子コンピュータ(関連技術)
量子コンピュータ(関連技術)	坂本健(NTT研究所)/加藤千晴(村田製作所)
	◆将来の高性能計算機:古典から量子まで 国立研究開発法人 理化学研究所 計算科学研究センター プロセス研究チーム チームリーダー 佐野 健太郎 ◆5G/6Gテクノロジーと光子量子コンピューター 東京大学 工学系研究科 物理工学専攻 教授 国立研究開発法人 理化学研究所 量子コンピュータ研究センター 副センター長 古澤 明 ◆国産量子コンピュータの制御装置の開発 大阪大学 量子情報量子生命研究センター 副センター長・准教授 キュウレ(株) 取締役CSO 根来 誠

【C】	C-3 デバイス技術・応用技術
デバイス技術・応用技術	山本浩之(マイクロン)/森義弘(SCREEN)
	◆次世代チップレット実現のためのコア技術開発課題と現状 大阪公立大学・量子超加工ラボ 客員教授・代表 佐子 勝 ◆High Bandwidth Memory - HBM マイクロメモリ ジャパン(株) Technology Development/Advanced Process Development/Sr Manager-BEOL 横井 直樹 ◆コンピューティング・パワー1000倍の実現に向けた切り札:AIペー ス設計ソリューション~AIパワーで、より高性能な半導体を、より短 期間、より低コストで開発 日本シノプシス合同会社 Customer Success Group Director, Applications Engineering 石村 大地

【D】	D-3 高密度実装
高密度実装	不破保博(元ローム)/藤原健典(東レ)
	◆パネルレベルファンアウトFOLP®を用いた先端パッケージング技術 アイオー電子(株) 製品企画開発部 課長代理 黒野 淳史 ◆3D実装時代の先端実装技術 ~これからのAI時代を支える最先端LSIの開発を目指して~ ヤマハロボティクスホールディングス(株) 先端技術開発センター センター長 谷口 恭弘 ◆半導体パッケージ向け材料の動向 味の素ファインテック(株) 研究開発部 第3グループ グループ長 宮本 亮

【E】	E-3 中・韓・印 アジア半導体産業の最前線を追う!
中・韓・印 アジア半導体産業の最前線を追う!	松下晋司(産業タイムズ社)/戸所義博(イーセップ)
	◆中国・印度の半導体産業はどのような? ~その現在地と展望~ (株)産業タイムズ社 取締役副社長 電子デバイス産業新聞 特別編集委員 津村 明宏 ◆中国デリスキングに悩む韓国半導体 (株)産業タイムズ社 ソウル支局長 巖 在漢